
Inhaltsverzeichnis

Impressum	2
Vorwort	3
1 Fachwissen Mikroverbindungstechnik	11
Das Phänomen der effektiv negativen thermischen Dehnungskoeffizienten an DCB-Substraten für Leistungsanwendungen R. Dudek, J. Hammacher, R. Kohl, B. Schuch	13
Ultradünne Chips in flexibler Elektronik S. Endler, E. A. Angelopoulos, S. Ferwana, C. Harendt, M.-U. Hassan, J. N. Burghartz	26
Flexible Schaltungsträger mit eingebetteten, flexiblen ICs J. Wolf, J. Kostelnik, A. Kugler, C. Harendt, H. Remp	35
Einflussfaktoren der Porenbildung auf der Leiterplatten-Endoberfläche beim Reflowlöten T. D. Ewald, N. Holle, K.-J. Wolter	44
In-situ-Widerstandsmessung im Temperaturwechseltest für die Zuverlässigkeitsbewertung neuer Leiterplattentechnologien S. Frühauf, D. Grumbach, E. Leske, K. Schmieder, U. Weber, K. Weise	58
Herstellung und Anwendungsspektrum mikro-nano-strukturierter Oberflächenmetallisierungen R. Schmidt, W. Scheel, M. Zwanzig, Stefan Fiedler, Berlin	73
Die Korrosion von Kupfer durch verschiedene Schadgase und Schadgas-Gemische G. Vogel	88
Neue Drahtwerkstoffe für den Einsatz im Wedge/Wedge-Bondprozess U. Geißler, M. Schneider-Ramelow, E. Milke	100

Erkenntnisse, Handlungsempfehlungen und Verfahrenslimitierungen zur Nacharbeit und Reparatur elektronischer Baugruppen T. Lauer	112
Mikrowellenhärtung von Beschichtungen und Vergussmassen für elektronische Baugruppen M. Nowotnick	124
Alterungsverhalten bleifreier Zinnbasislote im Temperaturbereich bis 200 °C T. Herberholz,	136
Benetzungseigenschaften bleifreier Lotpasten J. Trodler	149
Prozessoptimierung beim Selektivlöten für Anwendungen in der Leistungselektronik S. Wege, F. Ansorge, H. Schimanski, M. Poech	157
Temperatur- und Lötbeständigkeit von Lötstopplacken – wo sind die Grenzen der Belastbarkeit? M. Suppa	171
Steigerung der Lebensdauer elektronischer Komponenten und Sensoren durch eine neuartige Kombination von Klebe- und Dichttechnik J. Kolbe	186
Präzisions-Materialauftrag für SiP-Herstellung mittels Jet-Verfahren K.-F. Becker	203
Autorenverzeichnis	220
2 Allgemeine technische Informationen	223
Glossar	225
Technische Regeln	257

3 Firmenportraits	269
4 Anschriften Organisationen, Verbände, Institute, Ausbildungsträger	281
Ausbildung im Bereich der Mikroverbindungstechnik	283
Beratung und Begutachtung im Bereich der Mikroverbindungstechnik	285
Verbände im Bereich der Mikroverbindungstechnik	285
5 DVS – Die Verbindungs Spezialisten	287
Eine starke fügetechnische Gemeinschaft	289
Es gibt viele Gründe für eine Mitgliedschaft im DVS – Die 10 wichtigsten finden Sie hier	290
Internationalität „hoch vier“ im DVS-Jahr 2013	292
Die DVS-Landes- und Bezirksverbände	296
DVS-Anschriften	299
Zahlen aus der Arbeit des DVS und der DVS Media GmbH	311
Vorstandsrat	312
Präsidium	312
Organisation der Hauptgeschäftsstelle	313
Ausschuss für Technik (Aft) des DVS – Aufgaben und Ziele	314
Fachgesellschaft „Löten“	316
Fügetechnische Gemeinschaftsforschung 2010	317
DVS-Gremien auf dem Gebiet der Mikroverbindungstechnik	327

DVS-PersZert®	332
Ausschuss für Bildung (AfB)	333
Arbeitsgruppe Schulung und Prüfung (AG SP)	334
Hauptprüfungs- und Zertifizierungsausschuss (HZA)	334
DVS Media GmbH – Fachinformationen für die Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik	335
DVS-TV – Internet-Fernsehen für Fügen, Trennen und Beschichten	336
6 Waren- und Dienstleistungsverzeichnis	337
Übersicht zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis	339
Suchwortverzeichnis	340
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis	342
Alphabetisches Firmenverzeichnis	346
Inserentenverzeichnis	348
7 Kalender	349
Veranstaltungen 2012 – 2014	351
Kalender 2013 – 2019	354